



Development Change Management Project Manager

外資系半導体メーカーでの募集です。パッケージ開発のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

外資系半導体メーカー

Job ID

1483372

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

5.5 million yen ~ 11 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 6日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末...

Refreshed

July 5th, 2024 13:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Fluent

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2236267】

- ・ Responsible for OSAT change management projects ensuring projects are executed fulfilling project requirements.
- ・ Responsible for automotive package outline design change bill of material 2nd source or assembly process improvement qualification to meet automotive business needs.
- ・ Manage subcontractors PCN (Product change notice) and executive change projects.
- ・ Identify package level opportunities for cost down and executes cost down projects.

・ Support Front End wafer related change management

Required Skills

【必須】 ・半導体のパッケージ開発のご経験 ・プロジェクトマネジメントのご経験 ・新製品のパッケージ開発 プロジェクトの導入 変更/転送 またはプロセス（アSEMBリとテスト）実務経験 ・ラミネートとリードフレームに関するプロセスと材料に関する知識 ・自動車業界のランプアップ～セールローンチまでの経験 ・英語/日本語ビジネスレベル ・ロジカル志向、チームワーカー+コミュニケーション力

Company Description

ご紹介時にご案内いたします